

COOメッセージ

コアとなる要素技術を磨いて 付加価値を追う

エンジニアの“やりたい”という気持ちを大切にしたい、と考えています。エンジニアにはいつも、どれだけ忙しくとも勤務時間のうち10%、5%は自分のやりたい要素技術開発をやるよう伝えています。お金が必要な時には、私の決裁で予算を捻出します。

以前当社に、従来にないグラインダ（研削盤）を作りたい、と提案してきたエンジニアがいました。普通、硬い素材は柔らかい砥石で削るものですが、硬い素材を硬い砥石で削るという常識を覆すようなコンセプトを打ち出してきたのです。どうしてもやらせて欲しい、と頑張るので、予算を工面して本人に半年ほど世界中を周ってもらい、本当に成功するか市場調査をさせました。その結果、「売れます」という回答だったので、予算を付けて製品化もしましたけれども、結果としてその時にはまだ時期尚早でした。しかし、数年後にSiC（炭化ケイ素）基板の加工用ニーズが出てきて非常に売れるようになり、Si（シリコン）基板やハイブリッド・ボンディング*用途でも今や、この技術が当社の優位性を世界中に示しています。常識というのは疑ってみるものです。

何十年と生き残っている会社をみると、どこも確固たるコア技術があり、多少値段が高くとも売れる商品や装置、ソリューションを持っています。半導体製造装置の世界にしても、コア技術のしっかりした装置で、かつそこに付加価値がなければ、安価な外国製の装置に淘汰されてしまうでしょう。だからこそ当社グループは、精密測定機器と半導体製造装置の事業を併せ持つ世界唯一の企業として、コアとなる要素技術に磨きを掛けつつ、半導体デバイスを作りながら測定するという付加価値を追い求めなければなりません。

* 2つ以上の半導体デバイスを、銅製の接続電極などを使わずに直接接続する技術。



代表取締役社長COO
木村 龍一

COOメッセージ

中期経営計画最終年度

新たなニーズに対応し、
半導体製造装置と精密測定機器の融合を推進

こうした考えのもと2022年にスタートした現中期経営計画は、最終年度の3年目を迎えています。連結売上高1,700億円、営業利益375億円、ROE15%という目標を掲げてきましたが、PC、スマホ、家電など民生デバイスの市況低迷が長期化していることにより、2024年半ばの事業環境が年度末まで続くのであれば、達成は難しい状況です。とは言え、中国市場は全般に堅調で、AIやSiCへの需要も高まっています。市場の雰囲気は変わりつつあり、市況の回復次第でこの規模には近い時期に十分到達できると考えています。2023年7月に稼働を始めた飯能工場も順調で、市況回復後に需要を満たせるだけの生産キャパシティは十分にあります。

現中期経営計画の期間中には、半導体製造装置事業と精密測定機器事業の融合を進めました。かつての縦割り組織を改編して互いに双方の技術会議に出席するようにし、顧客ニーズがどこにあるのかをそれぞれの視点を持ち寄って考えられるようにした結果、新たにリリースした装置やその機能という形で融合が結実しつつあります。

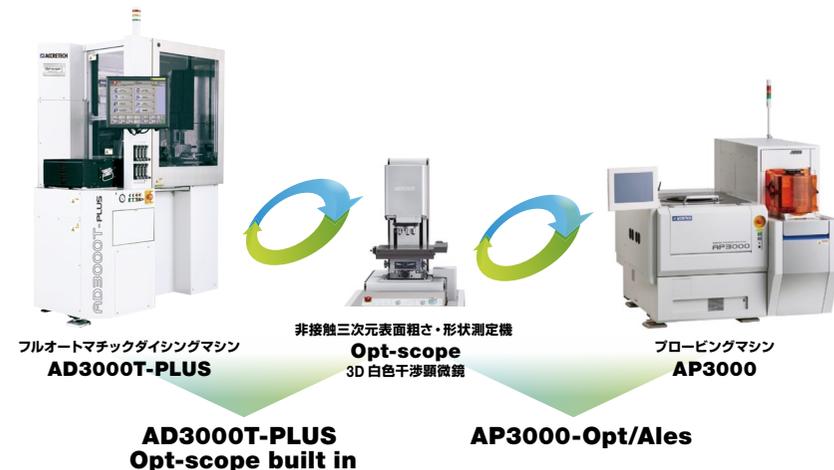
一例として挙げられるのが、当社グループで最も売上の大きいプロービングマシン*1に非接触の三次元表面粗さ・形状測定機「Opt-scope」を載せた事例です。従来の針跡検査は2次元での計測しかできませんでしたが、Opt-scopeの搭載により3次元（縦横+深さ）の計測ができるようになりました。同様にOpt-scopeをダイシングマシン*2に搭載することで、ウェーハの加工溝の底面の形状を把握できるようにもなっています。共に半導体製造工程の精度向上に貢献できるもので、半導体製造装置と精密測定機器、双方のコア技術を持つ当社グループならではの製品と言えるでしょう。他にも現在、数本のプロジェクトが進行中です。これらの新製品や販売先の拡充、マーケットシェアの上昇など、半導体製造装置と精密測定機器のシナジー効果による売上を3年以内に連結で130億円程度まで高めたいと思っています。

また、ハイブリッド・ボンディングという新工程の出現に対応できる、新たな装置の開発も進みました。先ほど触れた高剛性研削盤や、ウェーハの表面を研磨・平坦化する「CMP装置」で培った洗浄技術のグラインダへの転用などです。

ハイブリッド・ボンディングの過程で半導体同士を確実に接続するために、ウェーハの厚さをより均一に、平らにする必要性が高まる一方、半導体業界全体で前工程と後工程の境目が曖昧になってきています。例えば、AIに使うロジック半導体やHBM（高帯域幅メモリ）。一度後工程で薄く加工した後に、高レベルの清浄度が求められる前工程に戻す動きが出ており、後工程の装置にも微粒子、特に前工程に入り込んではいけな銅などの重金属を取り除く高い洗浄能力が求められるようになってきています。新開発した装置群は、このニーズを満たし半導体のさらなる高機能化への道を拓くものです。

近年は海外企業も自前の安価な半導体製造装置を市場に投入してきており、新たな付加価値を生み出せねば競争に負けます。お客さまや社内の声を丁寧に拾い、他社にできない、こういうものがあれば便利だ、という機能を実現し続けることが、当社グループが進むべき道だと思っています。

- *1：ウェーハの上に形成されたチップ一つひとつの電極に金属針（プローブ）を正確に当て、通電検査を行うための装置。
- *2：ウェーハ上に形成された多数のICなどを、一つひとつのチップに切り出す装置



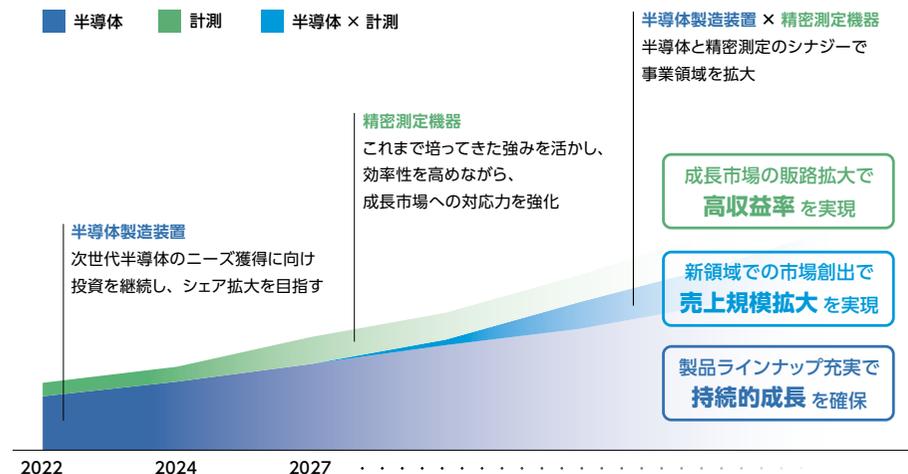
COOメッセージ

中長期ビジョン

「中小企業らしさ」と「やりたい」を実現できる環境」を守る

ここで視点を未来に向けてみます。社会全体がどう変わるかを予想することは困難ですが、どうあろうと半導体は絶対になくなりませんし、むしろIT技術の進捗で半導体デバイスが大量に必要となる時代が来るのはこれからです。精密測定機器もモノづくりがある限り必要であり続けます。それゆえ今後も、当社グループが半導体製造装置と精密測定機器を両輪として事業を行っていくことに変わりはありません。

現在の事業ポートフォリオのままでも、年間連結売上高2,000億円強までは十分到達できると考えており、シェアの拡大を通じてさらに数百億円は上乗せできる想定です。特に精密測定機器分野には、今後の成長が期待できるNEV（新エネルギー車）バッテリーの充放電試験システム・ソリューション事業があります。今後のNEVの増加と蓄電池需要の拡大は間違いありません。試験装置の開発にとどまらず、最新の情報や技術動向を得るために受託測定事業にも手を挙げたいと考えています。



それ以降については、自分たちで全く新しいことを考えることも重要ですが、お客さまから「こういうことはできないか」という声をいただき、その中に込められたエッセンスを見逃さずに事業の応用展開を図る、というイメージを抱いています。本社と海外現地法人のコラボレーションを一層発展させてグループの総合力を最大化し、真の国際企業へと成長していくことも長期の成長には不可欠でしょう。しかしそうして規模が拡大しても、小回りが効いて経営者が全体を見通せる「良い意味での中小企業らしさ」と、エンジニアの「やりたい」を実現できる環境は、今のまま保っていききたい。従業員が「上からの指示に従っていれば良い」と思い始めたら大企業病の始まり、工夫のしどころです。

次期中期経営計画

3年計画で良いのかを検討

このような未来への第一歩が2025年度から始まる次期中期経営計画になりますが、そもそも私は、「中計」という考え方が正しいのかどうか、少し疑問に感じています。当社グループの事業は装置産業であり、景気次第で売上高がかなり上下しますので、3年後にこうなる、ということは現時点では断言できません。良い時もあれば悪い時もあります。そして、中長期的には上がっていく、という世界です。

と言っても、定量目標がなければそれはそれで問題がありますので、中期経営計画自体は残すかも知れませんが、期限の切り方などについては考えなくてはならないと思っています。5年～10年の計画の方が向いているのかも知れません。なお、何をやるかについてはまだ申し上げられませんが、やりたいことは明確にあります。

COOメッセージ

ESGへの取り組み

デバイス作りに貢献することで、社会のお役に

「計測で未来を測り、半導体で未来を創る」というのが、当社グループのパーパスです。この言葉の通り、製品を通じて未来を創る、例えば世の中のCO₂が減るようなパワー半導体デバイスを作る際に役立つことで社会に貢献していくのが、当社グループのESGの在り方だと考えています。

もちろん、環境面では工場でさまざまな活動を手掛けており、サプライチェーンまでを含んだCO₂排出量の測定も行っています。ただ、我々は電気を多く使って製品を作る企業ではないので、直接CO₂排出量を減らすことで社会に貢献するというのは難しい。パワー半導体の高性能化に貢献する、あるいは化学物質を極力使わずに済む製造装置を提供することが、我々なりにできることです。

社会面では、ダイバーシティの推進に力を入れています。性別・国籍は当社グループでは一切問いません。最近では、海外現地法人の人財を本社に配属し、マネージャーとして日本人スタッフとともに海外営業をマネージングするという取り組みを始めました。海外営業は、肝心なところは言葉のニュアンスまで分かるネイティブの方が有利です。一方で、日本のことも分かるようになるので、5年10年して現地に帰った時にも必ず役に立つ。いずれは、そうした人たちの中から役員が出てくると思います。経営のトップになってくれても全然構いません。

ガバナンス面で現在進めているのは、後進経営層の育成です。候補者十数人に法律や経理に関する外部研修を受けさせるほか、さまざまな部署を経験させて視野を広げるようにしました。経歴や得意・苦手を示した候補者リストは社外取締役が委員を務める指名・報酬委員会に提出し、ご検討いただけるようにしています。

皆さまへのメッセージ

“やりたい”気持ちを大切に

皆の“やりたい”という声を大事にすることが、私が課長時代の30年前から変わらず抱いている信念です。あとは、東京精密という会社を好きであってくれば。皆が会社を好きになれば、そのベクトルはとても強いものになり、会社は必ず良くなります。

ステークホルダーの皆さまに対しても、同じことを考えています。株主・投資家の皆さま、お客さま、お取引先、地域の方々。皆さまの「こういうことがやりたい」という気持ちに応えていきたい、大事にしたい。そして好きになっていただきたい。今後とも、東京精密と末永くお付き合いください。

